

■ 財務概況

財務概況

損益状況

当期の事業環境

2018年3月期の世界経済は、米国や欧州の景気回復が着実に進み、中国をはじめアジア地域においても景気は底堅く、世界経済は総じて堅調に推移しました。

エレクトロニクス産業においては、動画配信など、各種クラウドサービスを通じた大容量データ通信が増大する中、データセンター向けの投資が活発に行われ、メモリを中心に半導体の需要が大幅に拡大しました。このような状況のもと、当社の参画する半導体前工程製造装置市場は前年比37%増加し、史上初となる500億ドル超えを記録しました。また、ディスプレイ産業においては、モバイル用のOLEDパネル向け設備投資に加えて第10.5世代の超大型パネル向けの投資も始まり、フラットパネルディスプレイ (FPD) 製造装置市場も、前年比40%増加の200億ドルに迫るなど、活況を呈しました。

売上の状況

良好な市場環境を背景に、最先端の半導体製造装置の需要拡大に加え、パーツ・中古装置販売や改造・保守サービスなどの需要も伸長し、当期の売上高は、前期比41.4%増加の1兆1,307億円となりました。セグメント別では、半導体製造装置の売上高は、前期比40.7%増加の1兆552

億円となりました。FPD製造装置の売上高は、前期比52.0%増加の750億円となりました。セグメント別の詳細については、8ページに記載されているセグメント別営業概況および事業展望をご参照ください。なお、フィールドソリューション事業 (パーツ・中古装置販売、改造・保守サービス) の売上高は、前期比20.5%増加の2,510億円となり、売上高全体の22.2%を占めました。

売上総利益、販売費及び一般管理費、営業利益

売上総利益は、売上拡大に伴い前期比47.4%増加の4,750億円となりました。売上総利益率については、主に高付加価値製品の売上拡大により前期比1.7ポイント上昇の42.0%となりました。

販売費及び一般管理費は、前期比16.4%増加の1,938億円となり、売上高販管費比率は前期比3.7ポイント低下の17.1%となりました。中期経営計画で掲げるコストコントロールについても着実に前進しました。これらの結果、営業利益は前期比80.6%増加の2,811億円となり、営業利益率は前期比5.4ポイント上昇の24.9%となり、過去最高を大幅に記録更新しました。

研究開発費

研究開発費は、前期比15.9%増加の971億円となりました。主な増加要因は、中期経営計画において市場シェア向

上に取り組んでいるエッチング装置、成膜装置、洗浄装置の研究開発を強化したことによるものです。また、単一装置の性能向上だけでなく、プロセス全体の最適化を実現する革新的な技術や、製品のインテリジェント化など、将来の製品競争力の向上を目的とした研究開発にも注力しました。

当社は、高い技術力が成長の源泉であるとの考えのもと、市場拡大が見込まれる分野を中心に、次世代の製品開発に向けて積極的に成長投資を行っています。当期は、最先端技術で製造されるDRAMや3D NANDフラッシュメモリにおいて、当社の注力分野の市場シェアが向上するなど、中期経営計画の達成に向けて成果が現れました。

FPD製造装置分野では、今後市場拡大が見込まれる第10.5世代に対応する新製品をリリースしました。

その他収益・費用および親会社株主に帰属する当期純利益

その他の収益・費用は、確定拠出企業年金制度への移行に伴う特別損失31億円、のれんの減損損失9億円などを計上したことにより、純額で59億円の費用となりました。この結果、税金等調整前当期純利益は前期比84.6%増加の2,752億円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は前期比77.4%増加の2,043億円、1株当たり当期純利益は前期比77.4%増加の1,245.48円となりました。

包括利益

当期純利益の2,043億円に加え、政策保有株式に関連する他有価証券評価差額金63億円、主に金利低下の影響による退職給付会計の割引率低下に伴う退職給付に係る調整額△44億円を計上したことにより、包括利益は2,061億円 (前期は1,199億円) となりました。

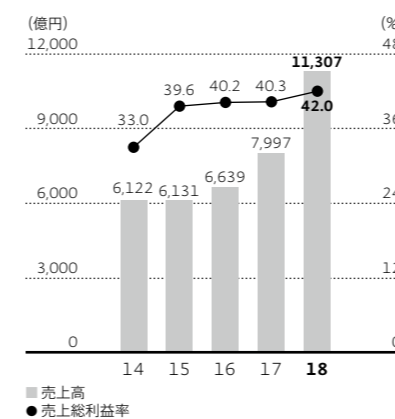
配当政策および当期配当金

当社は、業績連動型の配当を株主還元の基本方針としており、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向50%を目途とする配当を実施しています。さらに安定配当の観点も考慮し、1株当たり通期150円という下限設定も行っています*。これにより、当期の年間配当金は、好調な売上・利益成長を受けて、過去最高となる1株当たり624円 (配当性向50.1%) となりました。今後もグローバルレベルの収益力の構築を目指すとともに、利益成長を通して株主の皆さまのご支援にお応えしていきます。

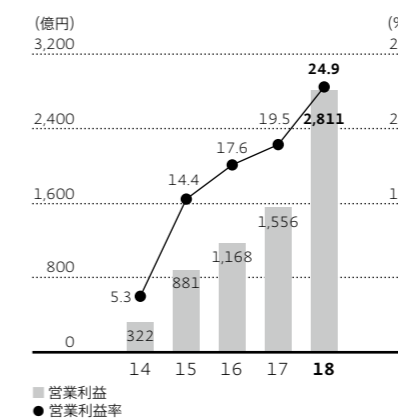
*2期連続で当期利益を生まなかった場合は、下限設定の見直しを検討します。

| 損益状況 | 百万円 | | | | |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 売上高 | ¥612,170 | ¥613,125 | ¥663,949 | ¥799,719 | ¥1,130,728 |
| 売上総利益 | 201,892 | 242,774 | 267,210 | 322,291 | 475,032 |
| 売上総利益率 | 33.0% | 39.6% | 40.2% | 40.3% | 42.0% |
| 販売費及び一般管理費 | 169,687 | 154,661 | 150,421 | 166,594 | 193,860 |
| 営業利益 | 32,205 | 88,113 | 116,789 | 155,697 | 281,172 |
| 営業利益率 | 5.3% | 14.4% | 17.6% | 19.5% | 24.9% |
| 税金等調整前当期純利益 (損失) | (11,756) | 86,828 | 106,467 | 149,116 | 275,242 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (損失) | (19,409) | 71,888 | 77,892 | 115,208 | 204,371 |

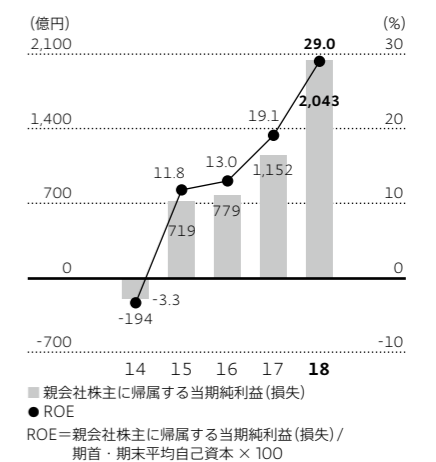
■ 売上高および売上総利益率



■ 営業利益および営業利益率



■ 親会社株主に帰属する当期純利益 (損失) および ROE



■ 財務概況

財務概況

財政状態及びキャッシュ・フロー

資産、負債及び純資産

■ 資産

流動資産は、前期末に比べ2,211億円増加し9,971億円となりました。これは主に、フリーキャッシュフロー*1 1,397億円の創出による手元資金*2の増加585億円、旺盛な半導体・FPD顧客の投資に対応した増産に伴うたな卸資産の増加1,078億円、受取手形及び売掛金の増加257億円によるものです。また、売上債権回転日数は52日(前期は61日)、たな卸資産回転日数は111日(前期は108日)となりました。

有形固定資産は、生産効率化に向け宮城工場内に新設した物流棟の建設費用、また次世代技術の開発強化に向けた開発関連設備などによる新規取得分456億円等により、純額で前期末から255億円増加し1,259億円となりました。

投資その他の資産は、前期末から45億円増加し、856億円となりました。

これらの結果、総資産は、前期末から2,512億円増加し、1兆2,087億円となりました。

*1 フリーキャッシュフロー：営業活動によるキャッシュ・フローおよび投資活動によるキャッシュ・フロー(取得から満期日までが1年内の短期投資などの増減額を除く)の合計

*2 手元資金：現金及び現金同等物に取得から満期日までが1年内の短期投資を加えた残高

■ 負債および純資産

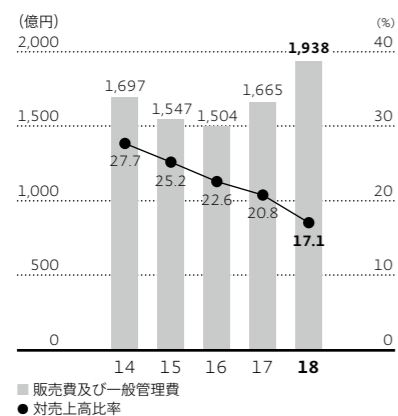
流動負債は、前期末に比べ1,206億円増加し、3,684億円となりました。これは主に、前受金の増加322億円、支払手形及び買掛金の増加293億円、賞与引当金の増加126億円、未払法人税等の増加349億円によるものです。

固定負債は、前期末に比べ50億円増加し、687億円となりました。

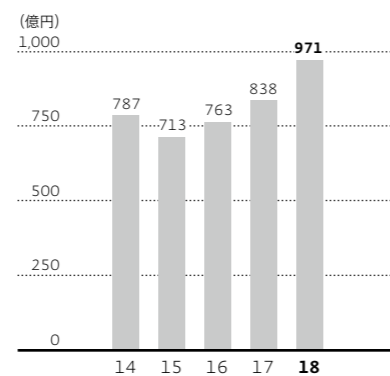
純資産は、前期末に比べ1,255億円増加し、7,715億円となりました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純利益2,043億円と配当金822億円(前期の期末配当367億円と当期の中間配当454億円)の計上などによる利益剰余金の増加1,220億円によるものです。

| 財政状態 | 百万円 | | | | |
|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 流動資産 | ¥621,492 | ¥670,883 | ¥617,416 | ¥775,938 | ¥ 997,102 |
| 有形固定資産 | 112,344 | 106,896 | 96,317 | 100,441 | 125,952 |
| 投資その他資産 | 94,756 | 98,375 | 79,635 | 81,067 | 85,650 |
| 総資産 | 828,592 | 876,154 | 793,368 | 957,447 | 1,208,705 |
| 流動負債 | 170,510 | 172,812 | 166,061 | 247,770 | 368,452 |
| 負債合計 | 237,978 | 234,991 | 229,129 | 311,447 | 437,195 |
| 純資産 | 590,614 | 641,163 | 564,239 | 645,999 | 771,509 |

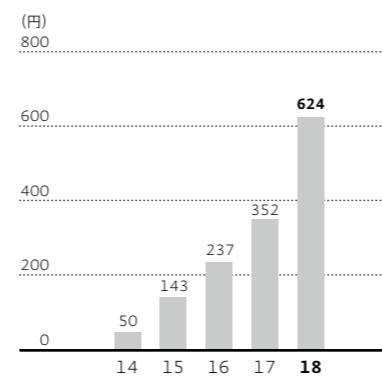
■ 販売費及び一般管理費および対売上高比率



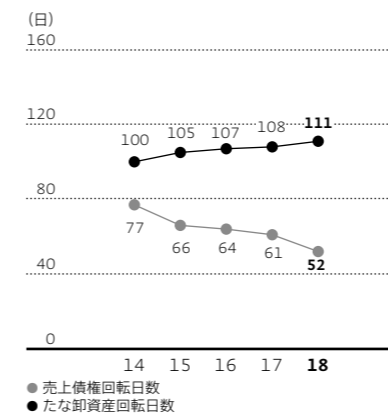
■ 研究開発費



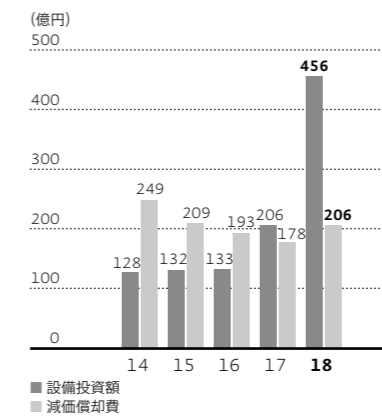
■ 1株当たり配当金



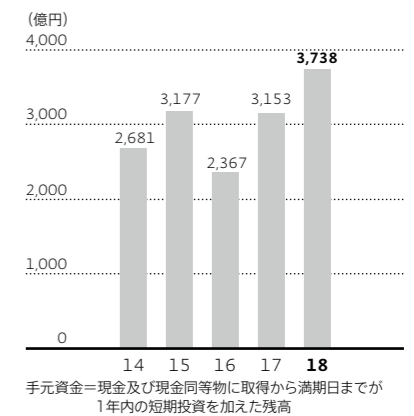
■ 売上債権回転日数およびたな卸資産回転日数



■ 設備投資額および減価償却費



■ 手元資金



この結果、自己資本比率は前期から3.7ポイント低下し63.5%となりました。なお、ROE(自己資本利益率)は前期の19.1%から29.0%に上昇しました。

設備投資*1および減価償却費*2

当期の設備投資額は、前期比120.3%増加の456億円となりました。主に、半導体製造装置事業における注力分野の強化に向けて、研究開発用機械装置などを取得しました。

減価償却費は、前期比15.4%増加し206億円となりました。

*1 設備投資額は有形固定資産の増加分を示しています。

*2 減価償却費にはのれん償却額および減損損失は含まれていません。

キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末に比べ935億円増加し、2,578億円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない取得から満期日までが1年内の短期投資を加えた手元資金は、前期末に比べ585億円

増加し、3,738億円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、前期に比べ496億円増加の1,865億円となりました。主な要因として、税金等調整前当期純利益2,752億円、前受金の増加316億円、仕入債務の増加285億円、減価償却費206億円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、たな卸資産の増加1,098億円、法人税等の支払額497億円、売上債権の増加259億円がそれぞれキャッシュ・フローの支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出417億円、短期投資の純減少による収入350億円により、前期の288億円の支出に対し118億円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払822億円により、前期の393億円の支出に対し825億円の支出となりました。

| キャッシュ・フロー | 百万円 | | | | |
|------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ¥ 44,449 | ¥ 71,806 | ¥ 69,398 | ¥136,948 | ¥186,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (19,599) | 155,738 | (150,014) | (28,893) | (11,833) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (187) | (18,214) | (138,601) | (39,380) | (82,549) |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 104,797 | 317,632 | 95,638 | 164,366 | 257,877 |

■ 財務概況

財務概況

事業等のリスク

当社の経営成績、財務状況及び当社株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

(1) 半導体市場変動による影響

当社は、技術革新が激しく自らの強みを発揮できる半導体製造装置等のハイテク分野に資源を集中させることにより、高い利益率を獲得してきました。半導体市場は技術の変化により大幅に成長する反面、需給バランスが崩れることによって市場規模が一時的に縮小することがあるため、当社はこのような局面においても利益を生み出せるように構造改革にも積極的に取り組んできました。しかしながら、予期せぬ市場規模の大幅な縮小によって、受注取消、過剰設備・人員、在庫増加、顧客の財務状況悪化による貸倒損失、仕入先の経営状態悪化による供給不足等が発生する場合には、当社業績に少なからず悪影響を及ぼす可能性があります。

(2) 特定顧客への取引集中による影響

当社は、優れた最先端技術を搭載した製品及び顧客満足度の高いサービス体制を通じて、国内の大手半導体メーカーを含む、世界中の主要な大手半導体メーカーとの取引拡大に成功してきました。大手半導体メーカーの大規模設備投資のタイミングによっては売上高が特定の顧客に一時的に集中することがあり、販売競争の激化によって当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(3) 研究開発による影響

当社は、微細加工技術、真空技術、プラズマ技術、熱処理技術、塗布・現像技術、洗浄技術、ウェーハ搬送技術、クリーン化技術等の最先端技術について積極的な研究開発投資及び研究開発活動を継続的に実施することにより、最先端の技術を創造するとともに、当該技術を搭載した新製品を早期市場投入することによって当社が参入する各製品分野において上位の市場シェアと高い利益率の獲得に成功してきました。しかしながら、新製品投入タイミングのずれ等の影響により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4) 安全に関する影響

当社は、開発・製造・販売・サービス・管理等の各種業務の遂行において安全や健康に対する配慮を常に念頭において行動するという基本理念のもと、当社製品の安全性向上や健康影響排除のために積極的かつ継続的に努力しております。しかしながら、当社製品に関連する安全性等の問題により、顧客への損害発生、受注取消等が発生した場合、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(5) 品質に関する影響

当社は、優れた最先端技術を積極的に開発し新製品に搭載し早期に市場に投入すると同時に、ISO9001の認証取得を含む品質保証体制の確立、及びレベルの高いサービス体制の確立にも努め、その結果、当社の製品を多くの顧客に採用していただくことができました。しかしながら、当社の製品が最先端技術製品である等の原因によって、未知の分野の開発技術も多く存在し、予期せぬ不具合品の発生等により当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(6) 知的財産権に関する影響

当社は、製品の差別化と競争力強化のために、最先端技術早期開発のための研究開発戦略を事業戦略及び知的財産戦略と三位一体で推進することにより、多くの独自技術の専有化を可能とし、各製品分野における高い市場シェアと利益率の確保に成功してきました。しかしながら、当社の製品は多くの最先端技術が統合・最適化された製品であることもあり、第三者の技術や特許その他の知的財産権を使用する上で制約される場合等があるため、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 外国為替変動による影響

当社は、事業の積極的な海外展開に成功したことにより、海外への売上高比率が高くなっております。当社の輸出は為替リスクを回避するために円建て取引にて行うことを原則としておりますが、一部外貨建て輸出も存在し、その場合には受注時の先物為替予約等によって為替リスクヘッジに努めております。しかしながら、急激な為替変動によって価格の変動が生じ為替リスクとなることがあり、当社業績に間接的に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) 企業買収による影響

当社は、事業戦略の一環として、新たな事業領域への進出、新技術・ビジネス基盤の獲得、既存事業の競争力強化などを目的とした企業買収を実施することがあります。具体的な実施にあたっては入念な調査・検討を行っております。しかしながら、買収後に当初期待した成果が十分に得られなかった場合には、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(9) 重要な訴訟等に関するリスク

当社は、現在においてその業績に重要な影響を与えうる訴訟等に関与しておりませんが、当社の事業活動等が今後重要な訴訟等の対象となり、その結果によっては当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(10) 法令、規制に関する影響

当社は、グローバルに事業を展開する上で、各国・各地域において、輸出入規制、環境規制、移転価格税制といった各種法令、規制の制約を受けており、その遵守に努めています。しかしながら、予期せぬ法令、規制の強化、改正が生じたこと等により、適切な対応ができなかった場合には、当社業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(11) その他リスク

当社は、新たな高成長・高収益事業の創出、既存事業における更なる高収益の追求、市場規模縮小時においても利益を生み出すことのできる体質への改善に積極的に取り組むとともに、環境保全活動の推進、コンプライアンスやリスク管理体制及び情報セキュリティ管理体制の再整備にも取り組んできました。しかしながら、当社が事業を遂行する限りにおいては、同業他社及び他業種企業と同様に、世界及び各地域における経済環境、自然災害、戦争、テロ、感染症等の不可抗力、金融・株式市場、政府等による規制、仕入先の供給体制、商品・不動産市況、国内外での人材確保、標準規格化競争、重要人材の喪失等の影響を受け、場合によっては当社業績に悪影響を及ぼすことが想定されます。